

电子

影目科技发布 AR+AI 眼镜，AI 眼镜终端如火如荼

投资要点：

➤ 影目两款 AI 眼镜齐上阵。

2024 年 11 月 29 日，AR 创新企业影目科技发布其创新成果的最新里程碑——两款接入 AI 大语音模型的智能眼镜：INMO AIR3 和 INMO GO2。INMO AIR3 采用了类普通眼镜的外观设计，镜框中央有一颗 1600 万像素 RGB 摄像头，用以摄影摄像、AI 识别等。相比 INMO AIR2，INMO AIR3 分辨率提升了 8.1 倍、视场角提升 2 倍，亮度提升 3 倍、刷新率提升 2 倍。INMO GO2 相比于上一代升级为双目双光机设计，FOV 达到 30 度，在高透过的衍射波导加持下，带来了更好的视觉体验。INMO GO2 还将在后续引入 AI 定向拾音算法，通提高在多人环境下的翻译精准度。根据 wellsenn XR 数据，2023 年~2024 年 Q3，AI 智能眼镜领域，影目科技产品在国内市场份额位居首位，占比约 41%，具有重要产业地位，其重磅产品发布将 AI 眼镜终端的趋势继续深化，加速发展。

➤ AI 智能眼镜为 AI 落地的最佳载体之一，2025 年将加速渗透。

传统终端无法满足的视觉需求不断推动着视觉技术的创新，而眼镜通过虚拟世界与真实世界的交互来为用户创造沉浸式的视觉环境，同时是靠近人体三大重要感官的穿戴设备，可以实现自然的声音、语言的输入输出。因此，基于能解放双手的穿戴式体验、与视觉高度融合的特点，智能眼镜正在成为重要的 AI 硬件落地形式。AR 眼镜或为 AI 的最佳载体之一，但其成熟之路是循序渐进的过程，而不带显示屏的 AI 眼镜作为 AI AR 眼镜的过渡形态，因具备 AI 交互功能，同时兼顾价格和基本性能，故而有望在 C 端快速渗透。而随着 AR 各硬件模块的完善和多模态 AI 的快速发展，AI 赋能下的 AR 眼镜有望成为 AI 智能眼镜的最终形态，引领可穿戴设备的新趋势。根据 wellsenn XR 预测，2025 年开始，AI 智能眼镜将快速向传统眼镜渗透；2029 年，AI 智能眼镜年销量有望达到 5500 万副；到 2035 年，AI 智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代，达到 70% 的渗透率。

➤ 投资建议

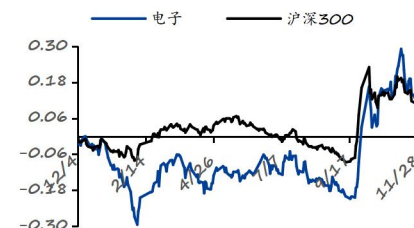
AI 眼镜终端方向，建议关注歌尔股份、亿道信息、立讯精密、华勤技术、水晶光电、韦尔股份、舜宇光学科技、兆易创新、佰维存储、恒玄科技、瑞芯微、炬芯科技、杰美特、长盈精密、京东方 A 等。

➤ 风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师：杨钟(S0210522110003)

YZ3979@hfzq.com.cn

联系人：唐小璿(S0210123120002)

zxm30169@hfzq.com.cn

相关报告

- 1、美对华科技封锁或将加码，自主可控加速攻坚——2024.11.25
- 2、24Q3AIPC 市场保持强劲发展步伐，AI 终端持续出新——2024.11.18
- 3、先进制程供应链再迎挑战，国产化迫在眉睫——2024.11.11



正文目录

1 本周市场表现.....	3
1.1 电子板块本周表现.....	3
1.2 SW 电子个股本周表现.....	3
1.3 电子板块估值分析.....	4
2 行业动态跟踪.....	6
2.1 半导体板块.....	6
2.2 AI.....	14
2.3 消费电子板块.....	15
2.4 汽车电子板块.....	18
2.5 面板板块.....	19
3 公司动态跟踪.....	20
4 风险提示.....	22

图表目录

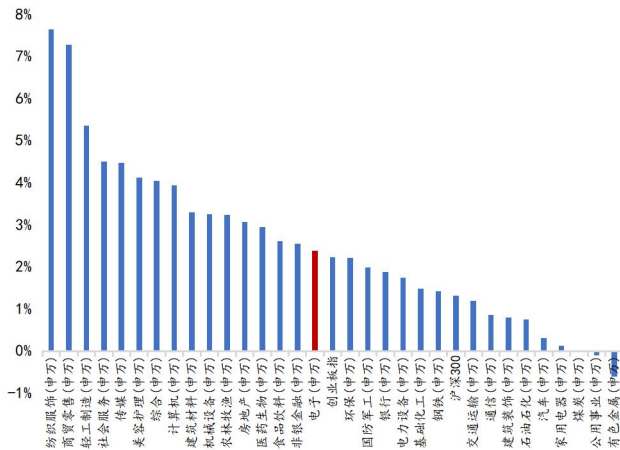
图表 1: SW 各行业板块本周市场表现.....	3
图表 2: 电子板块成交额及日涨跌幅.....	3
图表 3: 电子细分领域本周涨跌幅 (%).....	3
图表 4: SW 电子本周涨幅前十个股 (%).....	4
图表 5: SW 电子本周跌幅前十个股 (%).....	4
图表 6: SW 电子本周换手率前二十个股 (%).....	4
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM).....	5
图表 9: 过去一周股东增减持更新.....	20
图表 10: 过去一周股权激励一览.....	21

1 本周市场表现

1.1 电子板块本周表现

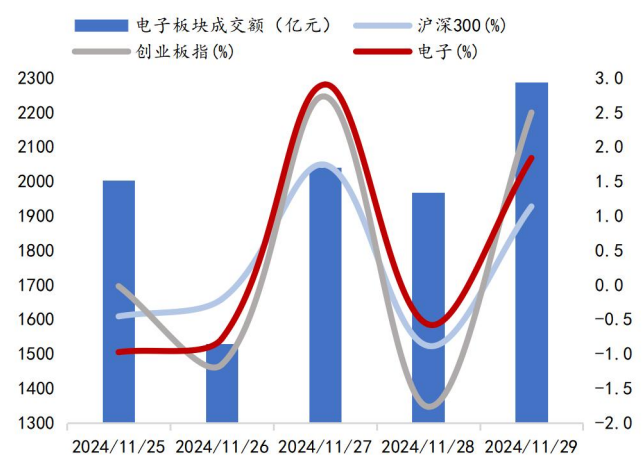
大盘表现上，本周（1125-1129）创业板指数上涨 2.23%，沪深 300 指数上涨 1.32%。本周电子行业指数上涨 2.38%。行业表现上，电子行业涨跌幅位列全行业的第 16 位，本周纺织服饰、商贸零售、轻工制造板块涨跌幅位居前列。

图表 1：SW 各行业板块本周市场表现



来源：Wind，华福证券研究所

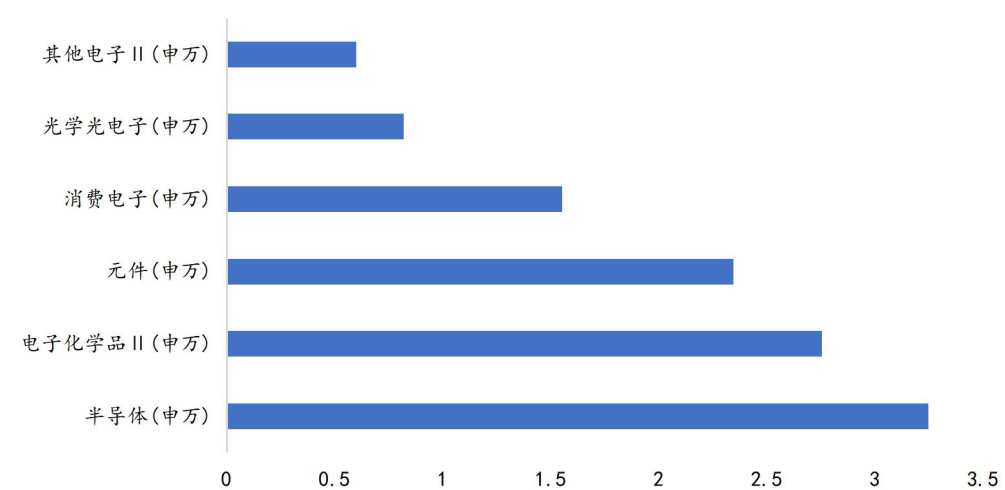
图表 2：电子板块成交额及日涨跌幅



来源：Wind，华福证券研究所

从电子细分行业指数看，本周电子细分板块均呈上涨态势，具体来看，半导体板块涨幅最大，周涨跌幅为 3.25%；其他电子板块涨幅最小，周涨跌幅为 0.60%。

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅 (%)

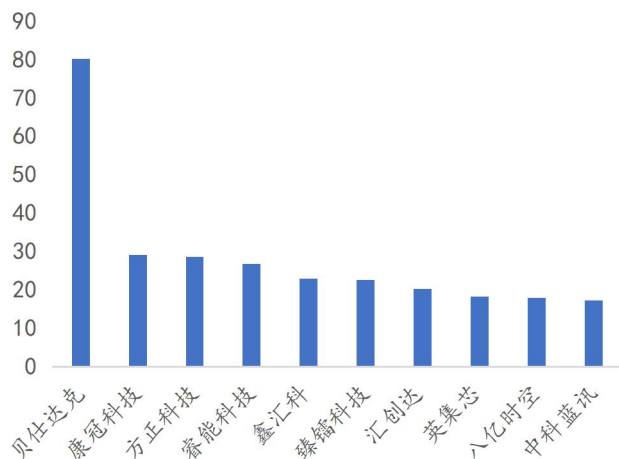


来源：Wind，华福证券研究所

1.2 SW 电子个股本周表现

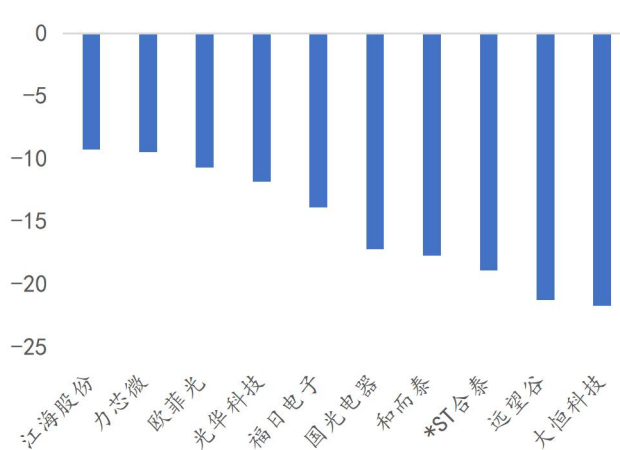
从个股维度来看，SW 电子板块中，贝仕达克（80.19%）、康冠科技（29.08%）等位列涨幅前列；大恒科技（-21.71%）、远望谷（-21.26%）等位列跌幅前列。

图表 4：SW 电子本周涨幅前十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

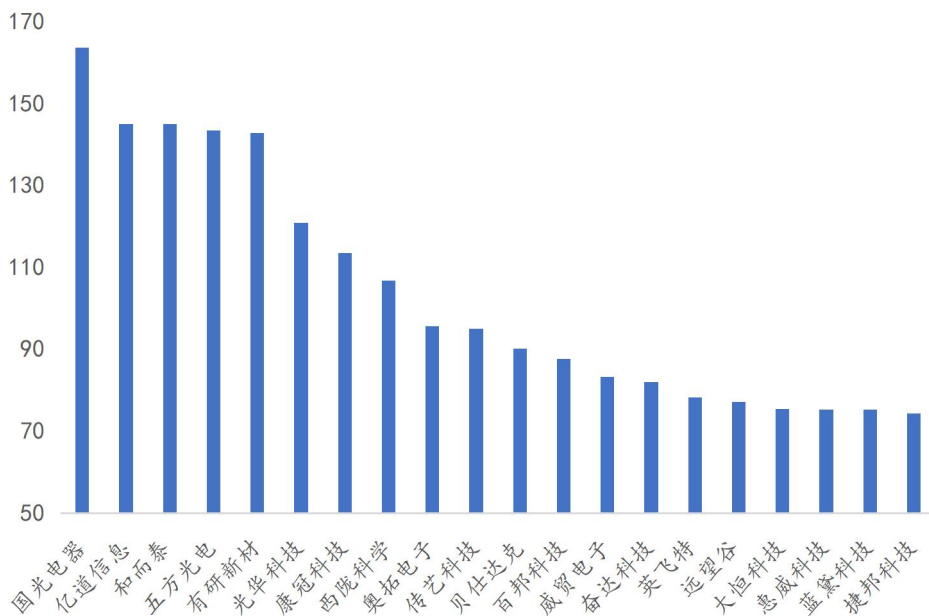
图表 5：SW 电子本周跌幅前十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

从换手率来看，本周电子行业个股换手率最高的是国光电器，换手率为 163.71%。其余换手率较高的还有亿道信息（144.00%）、和而泰（144.95%）、五方光电（143.51%）。

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%）



来源：Wind，华福证券研究所

1.3 电子板块估值分析

从本周 PE 走势来看，整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。本周 PE（TTM）为 54.06 倍，较上周有所上调。



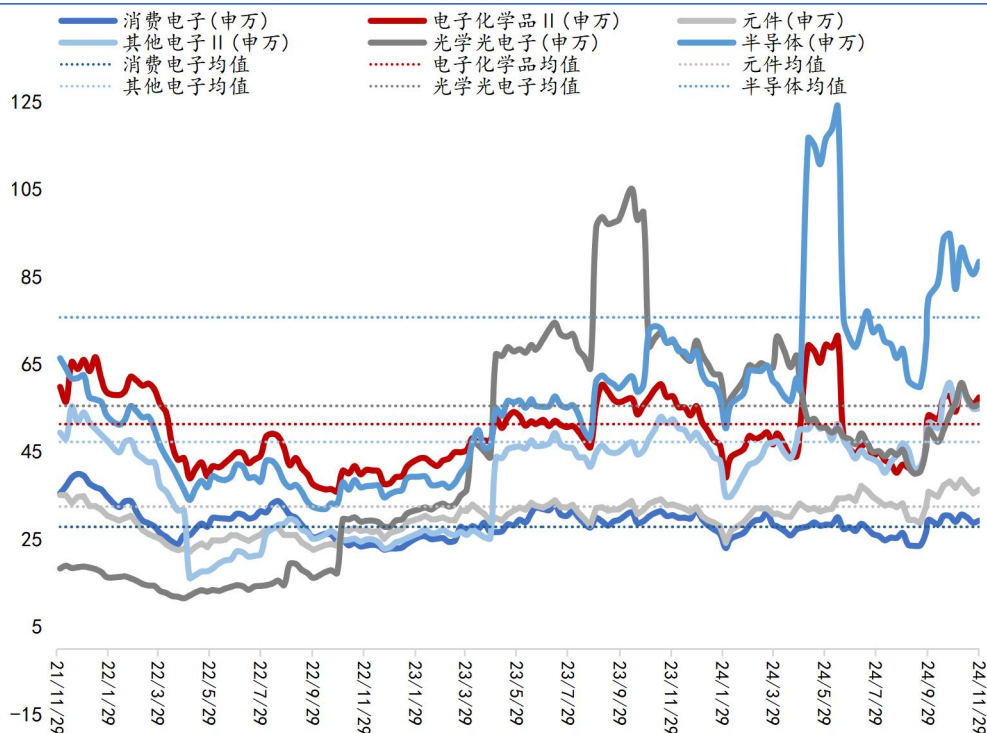
图表 7: SW 电子行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所

细分领域上, 本周消费电子、电子化学品、元件、其他电子、光学光电子和半导体板块 PE 分别为 29.26、57.43、36.33、54.92、55.83 和 88.46, 本周电子细分板块估值均有一定程度上调。

图表 8: SW 电子细分行业指数 PE 走势 (TTM)



来源: Wind, 华福证券研究所



2 行业动态跟踪

2.1 半导体板块

1) 拜登政府“小院高墙”最后一搏，中国应探索“内外统筹”反制路径

在政权过渡时期，拜登政府还在酝酿似乎冲击力更剧烈的“大招”。

业界盛传美国政府近日将对华实施新出口禁令，新规定可能会将多达 200 家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货，其中可能包括限制向中国出口芯片制造工具。另外，作为更广泛的人工智能计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽内存芯片（HBM）的规则预计将于下个月公布。

然而，拜登政府出口管制新规一再延迟“跳票”，也说明其面临的压力和挑战不言而喻，包括政界、商界等各方力量仍在针对所谓管制措施进行迂回争论和修订，同时该举措被视作确保其政治遗产得以延续，而影响无异于“杀敌八百，自损一千”。但面对美国的系列制裁措施，国内仍需做好应对，初步探索“内外统筹，多元并举”的反经济制裁路径。

关于美国拟更新出口管制新规，包括扩展贸易限制名单以及限制芯片制造工具和存储芯片出口其实早已有传闻。

据此前报道称，美国政府拟在 8 月出台一系列新制裁措施，包括阻止美光、SK 海力士、三星向中国企业供应用于人工智能的 HBM 芯片；将大约 120 家中国实体添加到制裁名单中，涵盖 6 家芯片制造工厂以及一些设备制造商、EDA 等相关公司等；限制中国台湾、马来西亚、以色列、新加坡等地的半导体企业与中国半导体企业的合作。

可以看出其与上述曝出的信息有较高重合度，同时若将制裁名单由 120 家增加至 200 家也显示出其管控力度加大，但美国出口管制新规也鉴于复杂形势出现一再延迟“跳票”。

总体上，随着美国对华战略打压的态势愈加严峻，美国对华制裁或将会进入更加“紧密”的阶段。行业分析认为，在对华出口管制上，川普 2.0 将从拜登政府的“小院高墙”升级“高院高墙”，将更全面性、更具针对性的针对中国半导体、AI 等产业进行打压。但也有观点指出，川普 2.0 将进一步推行美国单边主义，在全球协同盟友进行管制方面将遭遇挑战。（资料来源：集微网）

2) 三季度全球 NAND 闪存产业营收增长 4.8%

近日，根据 TrendForce 集邦咨询的数据显示，2024 年第三季度全球 NAND 闪存产业整体营收达 176 亿美元，季增 4.8%，但出货量环比下降 2%，ASP（平均销售价格）上涨 7%。



TrendForce 表示，第三季度 NAND 闪存定价趋势在各个应用领域呈现分化。

企业级 SSD 需求强劲，推动平均售价上涨近 15%，而客户级 SSD 价格在订单减少的情况下仅出现小幅增长。

TrendForce 称，由于中国智能手机品牌坚持低库存策略，智能手机 NAND 闪存产品订单减少，合约价格与上一季度基本持平。与此同时，由于零售市场需求疲软，晶圆合约价格出现逆转并开始下跌。（资料来源：集微网）

3) 台积电引领高端制程，估非 AI 半导体需求 2025 年回升

研究机构 Counterpoint Research 11 月 29 日发布 2024 年第三季全球晶圆代工产业相关新闻稿，其中提到台积电引领高端制程市场并估非 AI 半导体需求 2025 年稳步回升。

该机构分析，全球晶圆代工产业 2024 年第三季度营收季增 11%，年增 27%，受 AI 与高端制程智能手机需求带动，包括台积电 N5 和 N3 在内的高端制程成为晶圆代工产业的主要增长动力，受 AI 和智能手机半导体需求强劲支撑。非 AI 半导体需求依然疲软，但成熟 12 英寸制程的需求复甦表现优于 8 英寸制程。

该机构分析，至于中国大陆晶圆代工厂商如中芯国际和华虹半导体在成熟制程领域表现超越全球同行，总体产能利用率回升至 90% 以上，得益于中国大陆需求复苏及本地化进程推动。随着更多新增产能投入运行，预计进入 2025 年后，成熟制程晶圆代工市场的竞争将进一步加剧。

该机构分析，台积电 2024 年第三季度表现强劲，凭借 AI 加速器需求及智能手机旺季带动，其 N5 与 N3 制程利用率居高不下，毛利率表现优于市场预期。台积电的全球晶圆代工市占率从第二季的 62% 上升至 64%。台积电预期未来 AI 需求将大幅增长，2024 年 AI 服务器收入占其总营收的比重已达中双位数，并有望进一步提升。即便宣布将于 2025 年再次至少倍增其 CoWoS 产能，仍不足以满足客户对 AI 需求的强劲需求。此外，台积电预计非 AI 半导体需求将于 2025 年起稳步回升，缓解市场对半导体週期触顶的担忧。（资料来源：集微网）

4) 芯片战争作者：川普 2.0 聚焦减税，补助半导体厂机率低

美国依芯片法提拨 390 亿美元补助金，如今川普再次上台，外界忧补助生变。《芯片战争》作者米勒表示，两党都挺芯片法，未来框架不至于大规模变动，但新一届国会聚焦减税，未来批准更多补助的可能性低。

2022 年美国国会在两党支持下通过芯片法，允诺提供补助给 21 家企业，借此吸引芯片制造商将产线从亚洲拓展到美国。补助金多流向台积电、英特尔、三星电子等。

他推测，美国政府与不同半导体公司签署的许多协议将在今年底之前完成，也



就是在拜登政府任期结束前，代表这些协议将大致抵定，芯片法的补助金流向也相当明确。

芯片法提拨的 390 亿美元补助金用罄后，是否会出现芯片法 2.0 持续予以补助，以维系美国芯片制造动能，米勒并不乐观。他指出，政府已经决定如何支配已拨出的 390 亿美元，未来如果想要更多的资金就需国会批准，但新一届国会将聚焦减税，不利半导体业者获得更多补助。

对于川普上任前就喊加关税的影响，米勒说，从川普第一任期可见他毫无顾忌地祭出关税威胁，但最后只有一部分得以实施，期间也进行许多谈判。川普再次上台后，一来一往的谈判应该也不少，实际落实的关税可能远远低于宣称的数字，范围也没有那么广。

米勒也认为，美国在半导体制造领域将持续与中国台湾、日本及韩国合作，因为国际半导体供应链之所以能运作，完全依赖欧美、中国台湾、日本和韩国合作，没有任何一国能够自给自足，也不可能实现自给自足，就看具体条件怎么谈。

米勒认为，美中 AI 芯片运算能力未来几年可能保持一样的差距，因为台积电在技术上仍将明显领先中国大陆的中芯国际。虽然有人可能认为未来更先进的芯片制造技术未必那么重要，但至少在未来几年内，能否取得台积电的技术仍是重中之重。（资料来源：集微网）

5) 全球 DRAM 市场 Q3 营收大增 13.6%至 260 亿美元

据分析机构 TrendForce 的研究显示，2024 年第三季度全球 DRAM 市场规模达到 260.2 亿美元，环比增长 13.6%。

这一增长主要得益于数据中心对全球 DRAM 和 HBM 产品需求的增加，尽管由于中国智能手机品牌减少库存以及中国 DRAM 供应商扩大产能，LPDDR4 和 DDR4 的出货量有所下降。

ASP（平均销售价格）延续了上一季度的上升趋势，合约价格上升了 8%至 13%，这得益于 HBM 取代传统 DRAM 生产。

展望 2024 年第四季度，TrendForce 预计整体 DRAM 出货量将环比增加。该机构表示，由于 HBM 生产导致的产能限制预计对价格的影响将“弱于预期”。中国供应商的产能扩张可能会促使 PC OEM 和智能手机品牌“积极去库存”以获取价格更低的 DRAM 产品。因此，传统 DRAM 的合约价格以及传统 DRAM 和 HBM 的混合价格“预计将下降”。

服务器和 PC DRAM 合约价格的上涨在第三季度提升了三大 DRAM 制造商的收入。三星以 107 亿美元的营收保持了第一的位置，环比增长 9%。通过战略性地清理 LPDDR4 和 DDR4 库存，三星的出货量与上一季度持平。



SK 海力士的营收为 89.5 亿美元，环比增长 13.1%，保持了第二的位置。尽管其 HBM3e 出货量增加，但由于 LPDDR4 和 DDR4 销售疲软，出货量环比下降了 1% 至 3%，抵消了这些收益。

美光的营收环比激增 28.3%，达到 57.8 亿美元，得益于服务器 DRAM 和 HBM3e 出货量的“强劲增长”，导致出货量环比增加了 13%。（资料来源：集微网）

6) 透视意法与华虹合作，国产芯片成熟制程发力

近日，有消息称，意法半导体宣布将与华虹半导体合作，到 2025 年底在无锡生产 40nm 工艺节点的微控制器（MCU）。在中美贸易冲突持续加剧，一些国际企业筹谋将供应链转移出中国大陆的背景下，意法半导体的这一举措颇为醒目。业界对于此举的解读多为，意法半导体受到中国新能源汽车市场高速发展的吸引，希望加大大地化投入，增强对用户的响应速度。这当然无可争议，但是同时还应注意到，中国企业的芯片制造能力，特别是在成熟制程方面，经过一段时间的努力已经取得较大进步，并且获得国际大厂的认可。这也是本次合作得以达成的必要因素。

意法加强中国本土供应链

近年来，中国新能源汽车产业快速成长，不仅在国内市场占据显著份额，还在国际舞台上展现强劲竞争力。这一蓬勃发展的态势吸引了越来越多国际芯片大厂的注意，并且积极寻求合作。意法半导体在电动汽车的碳化硅与微控制器领域都是国际领先的供应商，用户包括特斯拉和吉利等，近年来也在不断加大对中国市场的投入。

受到工业和汽车领域营收下滑等因素的影响，意法半导体第三季度营收同比下降 27% 至 32.5 亿美元，净利润同比下降 67.8% 至 3.51 亿美元。在此情况下，意法半导体更加希望能够通过扩展 12 英寸硅晶圆和 8 英寸碳化硅工艺的产能，以对冲相关的市场风险。而中国既是最主要的新能源汽车市场，近年来在芯片成熟制程方面又取得显著进展。这或许正是意法半导体与华虹半导体达成合作的主要原因。

华虹成熟制程受青睐

华虹半导体是国内第二大晶圆代工厂，一直以来都致力于成熟特色工艺的开发。据报道，华虹半导体可以提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。同时，华虹半导体还积极拓展知识产权（IP）设计、测试等配套服务，进一步丰富产品线，提升综合竞争力。

目前，在全球范围内，面向成熟制程的 12 英寸晶圆生产线建设成为大趋势。华虹半导体在不断提升技术实力的同时，也在不断扩充 12 英寸产能，力争在 12 英寸成熟特色工艺领域保持领先地位。资料显示，华虹半导体除在上海金桥和张江建有



三座月产能约 18 万片的 8 英寸晶圆厂之外，在无锡还建有一座月产能 9.45 万片的 12 英寸晶圆厂。这不仅是全球领先的 12 英寸的集成电路特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前，华虹半导体正在推进华虹无锡二期 12 英寸生产线的建设，预计明年第一季度到上半年，新产线将开始贡献销售收入。

成熟制程产能占比将达 39%

华虹半导体在成熟制程方面的快速发展只是近年来国产芯片制造领域的一个缩影。由于受到美国政府对华芯片产业的无故打压，先进制程技术和设备进口受到管制，国内企业转而扩大投入成熟制程的开发。长期以来，中国一向是全球最大的芯片市场，面临本土产能严重不足的境况。在先进制程发展受限之下，只能从成熟制程进行积累，再慢慢向先进制程演进，这为中国成熟制程的发展提供了充足的动力。

根据集微咨询的统计，目前中国大陆已有 47 座晶圆厂，其中，12 英寸晶圆厂 22 座，8 英寸厂 25 座。此外，还有正在建设的晶圆厂 25 座。无论已建还是在建，大多均锁定成熟制程。研究机构 TrendForce 也预计，到 2027 年中国大陆成熟制程产能的全球占比将达到 39%。

值得注意的是，成熟制程的发展还带动了国内半导体装备材料等上游产业链的成长。目前中国已是全球最大的半导体设备需求市场之一，随着晶圆产能的持续扩张，对国产半导体设备的采购也将进一步增长。研究机构 TechInsights 预测，到 2029 年中国大陆半导体产能将增长 40%，达到 875msi（百万平方英寸）。而中国大陆的晶圆制造设备支出从 2018 年的 110 亿美元增长到 2023 年的近 300 亿美元。设备采购的增长成为设备制造行业发展的驱动力。（资料来源：集微网）

7) 台积电或在 2025 年后将先进 2nm 制造转移美国

特朗普胜选后，市场关注台积电 2nm 是否可能提前赴美生产。中国台湾科学技术部门官员吴诚文表示，台积电 2nm 制程将于明年量产，这时候台积电应已开始新一代制程的研发，就可以跟台积电讨论，是否要在友好地区投资 2nm。

吴诚文指出，特朗普竞选期间言论提及“抢走”，应该是半开玩笑。吴诚文强调，中国台湾并没有抢走美国的半导体技术，中国台湾半导体制造技术的能力，是台积电从 2000 年左右决定投入先进制程的研发开始，一步步拥有相关专利，“这些专利是我们自己开发出来的”。

吴诚文进一步表示，半导体技术涉及层面很广，包含设计、材料、设备、元件、理论，所谓技术，不能单纯简化到只有制造，从整体来讲，目前全世界最领先的仍是美国，但中国台湾在半导体的制造量、良率、获利能力方面，台积电绝对居全世界独一无二地位，是做得最好的公司。

在演讲中，吴诚文还被问及是否担心中国台湾半导体产业“空心化”。他回答



说，这种情况不太可能发生，因为台积电所有的研发设施都位于中国台湾地区内。尽管《芯片法案》鼓励台积电在美国设立制造工厂，类似的举措也吸引了该公司前往日本等其他国家，但这些交易并未促成台积电在国外设立研发中心。

吴诚文说明，先进制程技术的研发一定会留在中国台湾，研发成功以后，中国台湾也会愿意将之扩散到友好地区、协助其建厂。（资料来源：集微网）

8) 台积电 2027 年推出 9 个掩模尺寸的超大版 CoWoS 封装，可放置 12 个 HBM4 堆栈

台积电 11 月欧洲开放创新平台（OIP）论坛上宣布，该公司有望在 2027 年认证其超大版本的 CoWoS（晶圆上芯片）封装技术，该技术将提供高达 9 个掩模尺寸的中介层尺寸和 12 个 HBM4 内存堆栈。新的封装方法将解决性能要求最高的应用，并让 AI（人工智能）和 HPC（高性能计算）芯片设计人员能够构建手掌大小的处理器。

台积电每年都会推出新的工艺技术，尽最大努力满足客户对 PPA（功率、性能和面积）改进的需求。但有些客户需要更高的性能，而 EUV 光刻工具掩模限制 858 平方毫米是不够的。这些客户选择使用台积电 CoWoS 技术封装的多芯片解决方案，近年来，该公司提供了该解决方案的多个迭代版本。

该 9 个掩模尺寸的“超级载体” CoWoS（为芯片和内存提供高达 7722 平方毫米的面积）具有 12 个 HBM4 堆栈，计划于 2027 年获得认证，推测它将在 2027 年至 2028 年被超高端 AI 处理器采用。（资料来源：集微网）

9) 传小米 2025 年正式发布自研 3nm SoC 芯片

安卓智能手机制造商通常依赖高通和联发科提供“现成”的芯片，据说 2024 年和 2025 年的大多数高端版本都包含骁龙 8 Elite 和天玑 9400。小米在很大程度上也将依赖上述两家公司。然而，该公司很可能开始意识到，在未来维持对这些合作伙伴的依赖只会让成本变得更加昂贵，而提高盈利能力的唯一方法是启动其定制芯片业务。根据最新报道，小米将于 2025 年正式推出自研 3nm SoC 芯片，预计会让竞争对手感到紧张。该处理器可能有助于小米提高自给自足能力，并在由高通客户主导的安卓市场中脱颖而出。

报道指出，小米将在 2025 年正式推出自研手机 SoC 芯片，几乎已经是板上钉钉，半导体相关供应链也表示确有此事，指出小米已经准备好将在 2025 年正式量产，只是现在还无法完全确定，究竟这颗处理器会导入到哪一款机型。（资料来源：集微网）

10) 台积电高雄首座 2nm 晶圆厂设备进场，明年上半年试产

11 月 26 日，台积电高雄首座 2nm 晶圆厂举行了设备进场仪式，预计将于明年上半年开始试产。



台积电董事长兼总裁魏哲家在 10 月的法人说明会中表示，对 2nm 制程感兴趣的客户比预想的多，台积电将准备比 3nm 更多的产能。

此前台积电强调，2nm 制程技术研发进展顺利，其性能和良率均按计划实现，甚至部分表现优于预期，2nm 制程将如期在 2025 年进入量产，量产曲线预计与 3nm 相似。

消息人士称，台积电 2nm 制造业务将在新竹科学园区（HSP）宝山 F20 厂区和高雄楠梓 F22 厂区进行。宝山厂预计年底实现小规模试产线（mini line）完工，将于 2025 年第四季度开始生产，月产能约为 3 万片晶圆；高雄 F22 厂将于 2026 年第一季度开始商业化生产，月产能为 3 万片晶圆。（资料来源：集微网）

11) 2024 年 Q3 全球半导体营收排行：英伟达居首，英特尔跌出前三

据 WSTS 报告称，2024 年第三季度半导体市场增长 1660 亿美元，较 2024 年第二季度增长 10.7%，这是自八年前 2016 年第三季度 11.6% 以来的最高环比增幅。此外，2024 年第三季度同比增长 23.2%，是自 2021 年第四季度 28.3% 以来的最高同比增长。

在各大企业方面，凭借在 AI GPU 领域的实力，英伟达仍是 2024 年第三季度最大的半导体公司，营收达 351 亿美元。三星半导体以 220 亿美元的收入位居第二，AI 服务器内存被认为是主要的收入驱动因素。博通位居第三，其 2024 年第三季度的预期为 140 亿美元，AI 半导体倍成为重要增长动力。此外，英特尔和 SK 海力士位列前五。（资料来源：集微网）

12) 上半年全球半导体设备出货总额为 532 亿美元，中国大陆占比约 47%

近日，SEMI 在其发布的《全球半导体设备市场报告》中宣布，2024 年上半年，全球半导体设备出货总额为 532 亿美元，反映了迄今为止整个行业的健康状况。在战略投资的推动下，半导体设备市场已经恢复增长，以支持对先进技术的持续强劲需求，各个地区也在致力于加强其芯片制造生态系统。

SEMI 数据显示，中国大陆是世界上最大的半导体设备市场，今年前 6 个月，中国大陆在芯片制造工具上的支出达到创纪录的 250 亿美元（占全球半导体设备市场约 47%），超过中国台湾地区、韩国和美国的支出总和。此外，预计中国大陆还将成为建设新芯片工厂（包括相关设备）的最大投资者，全年总支出将达 500 亿美元。

此外，SEMI 在其发布的《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告》中指出，从 2025 年到 2027 年，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的 4000 亿美元。强劲的支出是由半导体晶圆厂的区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能（AI）芯片日益增长的需求推动的。

2024 年，全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将增长 4%，达到 993 亿美元，到



2025 年将进一步增长 24%，首次突破 1000 亿美元，达到 1232 亿美元。预计 2026 年支出将增长 11%，达到 1362 亿美元，2027 年将增长 3%，达到 1408 亿美元。其中，预计到 2027 年，中国大陆将保持其作为全球 300mm 设备支出第一的地位，未来三年将投资超过 1000 亿美元。（资料来源：集微网）

13) 台积电：N2P IP 准备就绪，客户现可设计性能增强型 2nm 芯片

台积电近期在欧洲开放创新平台（OIP）论坛上宣布，电子设计自动化（EDA）工具和第三方 IP 模块已为台积电性能增强型 N2P 和 N2X 工艺（2nm 级）技术做好准备。这使得各种芯片设计人员能够基于台积电的第二代 2nm 生产节点开发芯片，从而利用纳米片晶体管和低电阻电容器。

到目前为止，Cadence 和新思科技（Synopsys）的所有主要工具以及西门子 EDA 和 Ansys 的仿真和电迁移工具都已为台积电的 N2P 制造工艺做好准备。这些程序已经通过 N2P 工艺开发套件（PDK）0.9 版认证，由于使用此制造工艺的量产计划在 2026 年下半年进行，因此被认为足够了。

此外，第三方 IP，包括标准单元、GPIO、SRAM 编译器、ROM 编译器、内存接口、SerDes 和 UCIe 产品，现在以预硅设计套件的形式从各种供应商处获得，包括台积电自身、Alphawave、ABI、Cadence、新思科技、M31 和 Silicon Creations。2024 年第四季度推出 pre-silicon DK 似乎恰逢其时。（资料来源：集微网）

14) 前五大晶圆制造设备商前三季度来自中国营收年增 48%

近日，市调机构 Counterpoint Research 在报告中指出，2024 年前三季度全球前五大晶圆制造设备（WFE）厂商应用材料、ASML、TEL、科磊、泛林集团等营收增长 3%，存储需求成主要驱动力。

Counterpoint Research 指出，受到 DRAM 出货量的强劲增长，尤其是 HBM 的需求带动，2024 年前三季前五大晶圆制造设备（WFE）厂商在存储领域的营收年增 38%。在区域市场方面，该机构分析，前五大晶圆制造设备厂商前三季度来自中国的营收年增 48%，占总系统销售额的 42%。这一增长主要得益于成熟制程和存储相关设备的强劲需求。

对于 2024 年全年表现，Counterpoint Research 称，预计 2024 年全年，全球前五大晶圆制造设备厂商的总营收将比 2023 年增长 4%。生成式 AI 和高性能计算（HPC）的应用推进，将成为未来市场增长的主要动力。此外，随着终端需求逐步回暖，相关产业的投资力度也将进一步加强。到 2025 年，全球晶圆制造设备市场有望实现双位数增长，主要来自于领先制程技术的加速投资，以及存储新产能的持续扩展。（资料来源：集微网）

**15) SEMI：预计 2024 年 Q4 全球半导体资本支出同比增长 31%**

国际半导体产业协会（SEMI）近日在 2024 年第三季度半导体制造监测（SMM）报告中宣布，2024 年第三季度全球半导体制造业表现出强劲势头，所有关键行业指标两年来首次出现环比增长。增长受到季节性因素和对 AI 数据中心投资的强劲需求的推动，然而，消费、汽车和工业领域的复苏速度较慢。预计增长趋势将持续到 2024 年第四季度。

SEMI 指出，在 2024 年上半年下滑之后，电子产品销售额在 2024 年第三季度反弹，环比增长 8%，预计 2024 年第四季度环比增长 20%。IC 销售额在 2024 年第三季度也环比增长 12%，预计 2024 年第四季度将再增长 10%。总体而言，预计 2024 年 IC 销售额将增长 20% 以上，主要受存储产品的推动，因为价格全面上涨以及市场对数据中心内存芯片的强劲需求。

与电子产品销售类似，半导体资本支出（CapEx）在 2024 年上半年有所下降，但从 2024 年第三季度开始趋势转为正值。2024 年第三季度，与存储相关的资本支出环比增长 34%，同比增长 67%，反映出内存 IC 市场与去年同期相比有所改善。预计 2024 年第四季度，半导体总资本支出将较 2024 年第三季度水平增长 27%，同比增长 31%，其中与内存相关的资本支出同比增长 39%，领先于这一增长。

半导体设备部门保持强劲，表现优于此前预期，这得益于来自中国的大量投资以及对高带宽内存（HBM）和先进封装的支出增加。2024 年第三季度，晶圆厂设备（WFE）支出同比增长 15%，环比增长 11%。中国的投资继续在 WFE 市场中发挥重要作用。此外，2024 年第三季度，测试、组装与封装部门分别实现了令人印象深刻的同比增长，分别为 40% 和 31%，预计这一增长将持续到今年剩余时间。

2024 年第三季度，晶圆厂产能达到每季度 4140 万片晶圆（以 300 毫米晶圆当量计算），预计 2024 年第四季度将增长 1.6%。晶圆代工厂和逻辑相关产能继续呈现强劲增长，2024 年第三季度增长 2.0%，预计 2024 年第四季度将增长 2.2%，这得益于先进节点和成熟节点的产能扩张。存储容量在 2024 年第三季度增长了 0.6%，预计 2024 年第四季度将保持同样的增长速度。这一增长是由对 HBM 的强劲需求推动的，但部分被工艺节点转换所抵消。（资料来源：集微网）

16) 传 AMD 有意跨足手机芯片领域，采用台积电 3nm 工艺

AMD 传出有意跨足手机芯片领域，扩大进军移动设备市场，相关新品将采用台积电 3nm 制程生产，助攻台积电 3nm 产能利用率维持“超满载”盛况，订单能见度直达 2026 下半年。

对于相关传闻，AMD 不予评论。台积电也不评论市场传闻，亦不评论与单一客户的业务细节。



业界盛传，AMD MI300 系列加速处理器（APU）在 AI 服务器领域快速冲刺之际，也规划要推出移动设备 APU 加速处理器芯片，采台积电 3nm 制程，扩大手机战线。

法人看好，AMD 今年有望续居台积电前三大客户，并与台积电延伸先进封装合作。根据 AMD 与台积电技术论坛发布的信息，AMD MI300 系列不仅采用台积电 5nm 家族制程，并借由台积电 3DFabric 平台多种技术集成，例如将 5nm 图形处理器与中央处理器（CPU）以 SoIC-X 技术堆栈于底层芯片，并再集成在 CoWoS 封装，实现百万兆级高速运算创新。（资料来源：集微网）

2.2 AI

1) 科技巨头带头激战，全球 AI 应用程式数量近七千个

科技巨头近年 AI 布局扩张快速，带动 AI 发展热潮，光是去年问世的 AI 应用程式就达到近 1,800 个，今年更是加速狂奔，让全球 AI 市场持续上演激烈交。

根据 Sensor Tower 估算，截至今年 10 月，全球 AI 应用程式数达 6,960 个，并研判 2024 年全球 AI 市场规模将突破 1,840 亿美元，较 2023 年的 1,359 亿美元大幅成长，2030 年更可望上看 8,276 亿美元，展现令人瞩目的表现。

Sensor Tower 指出，2023 年全球 AI 应用程式的下载量达 35 亿次，自 2014 年以来的总下载量高达 165 亿次。AI 应用程式内购（In-App Purchase）部分，2023 年使用者花费总额 31 亿美元，自 2014 年以来的总支出到 85 亿美元。

数据显示，Alphabet、微软、亚马逊和 Meta 等科技巨头，2025 年投入 AI 基础设施建设的资本支出超过 2,000 亿美元。（资料来源：集微网）

2) 英特尔新质生产力技术生态大会：深耕本土生态，推动 AI 惠及千行百业

11 月 26 日，英特尔新质生产力技术生态大会召开。这是英特尔近年来规模最大的行业活动，汇聚了 2000 余位业界伙伴，聚焦技术分享与生态合作，从商业洞察、未来战略、产业发展、生态共创等方面探讨如何释放 AI 潜能、推动行业变革的最佳路径，把握行业新机遇，实现新的创新和高质量发展。

特别值得关注的是，本次大会上，英特尔在科技体验区安排了大量有关生成式 AI 的案例 Demo 展示。令人直观体验到大模型已越来越多地在制造、教育、零售、医疗等领域落地，显示出赋能千行百业的巨大潜力，同时也体现了英特尔长期深耕中国本土产业生态的努力。

在英特尔至强 6 能效核处理器产品展示区，展示了英特尔至强 6 能效核系列产品为云规模工作负载带来的独特优势，降低能耗成本，提高机架密度，增加新工作负载的容量，可以为客户提供高密度计算和横向扩展工作负载的最佳每瓦性能。英



特尔至强 6 性能核可以提供最高达到 128 个内核，采用超线程，内置矩阵引擎加速计算密集型人工智能、科学计算和数据服务工作负载。（资料来源：集微网）

2.3 消费电子板块

1) Q3 全球折叠屏智能手机出货量同比下降 1%，三星大降 21%

Counterpoint Research 发布的全球折叠屏智能手机市场报告显示，在经历连续六个季度同比增长后，2024 年第三季度全球折叠屏智能手机出货量同比下降 1%。这是该市场历史上首次在第三季度出现下滑，主要原因是三星全新 Galaxy Z6 系列表现平淡。

三星以 56% 的市场份额重新夺回全球折叠屏市场第一位置，但其出货量同比下降 21%。三星 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 的销量均低于预期，尤其是在中国市场，三星份额仅为 8%，远低于其在全球其他地区 82% 的领先地位。中国市场对折叠屏手机需求的强劲增长未能给三星带来预期的增长。

与此同时，小米（185%）、摩托罗拉（164%）和荣耀（121%）的折叠屏出货量同比增幅最大。

小米折叠屏全球市场份额升至 6%，创历史新高，其 MIX Flip 的推出以及积极拓展海外市场是其取得显著增长的重要原因。

在西欧市场，荣耀 Magic V 系列以其时尚的外观和轻薄的机身，对三星形成不小的压力。荣耀全球折叠屏市场份额为 10%。（资料来源：集微网）

2) 全球智能手机出货量今年有望恢复增长，预计出货 12.4 亿部

日前，据外媒报道，市场研究机构发布的报告显示，在连续两年同比下滑之后，全球智能手机的出货量在今年有望强势反弹，同比会有明显增长。

具体而言，市场研究机构是预计今年全球智能手机的出货量将达到 12.4 亿部，同比增长 6.2%。而从市场研究机构此前发布的报告来看，2022 年全球智能手机出货 12.7 亿部，同比下滑 6.5%；2023 年则是出货 11.7 亿部，同比下滑 3.2%。

就市场研究机构的报告来看，今年全球智能手机的出货量反弹，是得益于采用安卓系统的智能手机出货量同比增长 7.6%，而采用 iOS 系统的苹果 iPhone，在今年的出货量预计增长 0.4%，小幅增长，略好于去年。（资料来源：集微网）

3) REDMI 全球出货破 11 亿，新十年推全新标识，樊振东任形象大使

2024 年 11 月 27 日晚，REDMI K80 系列新品发布会在京举行。在新十年的开端，REDMI 品牌启用红色大写的全新品牌标识，并邀请樊振东担任冠军大使，共同诠释「当红不让」的全新品牌宣言，以更加强大、自信的姿态迎接新十年。同时「大



满贯双旗舰」REDMI K80 系列也正式发布，定位全面升档，带来 K 系史上最大的产品升级。

此次 REDMI K80 系列以 K80 Pro 和 K80「双旗舰」的组合呈现，在性能、屏幕、影像、续航等方面全面升级。K80 Pro 定位大满贯旗舰，在满血性能的基础之上，更有浮动长焦、50W 无线充、IP68/69 等旗舰科技，带来 K 系史上最大的升级，售价 3699 元起。K80 搭载狂暴引擎 4.0 加持的第三代骁龙 8 性能更强，配备 6550mAh 超大电量，搭载同价位罕见的 2K 直屏、超声波指纹、IP68 等，堪称行业「最强标准版」，售价 2499 元起。深度定制的 REDMI K80 Pro 冠军版 兰博基尼汽车 SQUADRA CORSE 售价 4999 元，目前 REDMI K80 全系已经正式发售。（资料来源：集微网）

4) 10 月国内手机出货量 2967.4 万部，5G 手机占比 90.1%

11 月 27 日，据中国信通院披露数据显示，2024 年 10 月，国内市场手机出货量 2967.4 万部，同比增长 1.8%，其中，5G 手机 2672.2 万部，同比增长 1.1%，占同期手机出货量的 90.1%。

2024 年 1-10 月，国内市场手机出货量 2.50 亿部，同比增长 8.9%，其中，5G 手机 2.14 亿部，同比增长 13.6%，占同期手机出货量的 85.5%。

2024 年 10 月，国内手机上市新机型 37 款，同比下降 26.0%，其中 5G 手机 22 款，同比下降 29.0%，占同期手机上市新机型数量的 59.5%。

2024 年 1-10 月，国内手机上市新机型 353 款，同比下降 8.3%，其中 5G 手机 186 款，同比增长 1.1%，占同期手机上市新机型数量的 52.7%。

从品牌构成来看，2024 年 10 月，国产品牌手机出货量 2345.8 万部，同比增长 30.2%，占同期手机出货量的 79.1%；上市新机型 37 款，同比下降 24.5%，占同期手机上市新机型数量的 100%。

2024 年 1-10 月，国产品牌手机出货量 2.11 亿部，同比增长 16.7%，占同期手机出货量的 84.6%；上市新机型 331 款，同比下降 7.0%，占同期手机上市新机型数量的 93.8%。

从国内智能手机发展情况来看，2024 年 10 月，智能手机出货量 2788.4 万部，同比下降 1.1%，占同期手机出货量的 94.0%；智能手机上市新机型 29 款，同比下降 19.4%，占同期手机上市新机型数量的 78.4%。

2024 年 1-10 月，智能手机出货量 2.34 亿部，同比增长 6.4%，占同期手机出货量的 93.5%；智能手机上市新机型 247 款，同比下降 21.6%，占同期手机上市新机型数量的 70.0%。（资料来源：集微网）



5) OPPO Reno13 系列正式发布

11月25日,OPPO正式推出OPPO Reno13系列。Reno13 Pro采用6.83英寸的四曲柔边小直屏设计,Reno13采用6.59英寸的超美小直屏设计。Reno13系列全系标配质感金属中框,并采用一体式冷雕玻璃工艺。Reno13系列还通过了IP69、IP68、IP66三项防尘防水测试,确保有效防范高温高压喷水、持续浸水、强烈喷水场景,真正实现了对整机的全方位防水守护。(资料来源:集微网)

6) 2024年全球笔记本电脑出货将增长3.9%至1.74亿台

根据TrendForce的报告,2024年全球笔记本电脑市场预计恢复增长,但受高利率和地缘政治不确定性的影响,预计年度出货量将达到1.74亿台,同比增长3.9%。展望2025年,预计美国总统选举后的政治不确定性减少和美联储在2024年9月的降息将刺激资本流动,再加上Windows 10的服务终止和商用设备升级的需求,全球笔记本电脑出货量预计将增长4.9%,达到1.83亿台。

TrendForce指出,笔记本电脑主要仍是生产力工具,出货增长主要由推迟替换需求驱动。目前,AI集成笔记本对整体市场的影响仍然有限。然而,预计AI功能将自然地融入笔记本电脑的规格中,随着品牌逐渐将其融入,AI笔记本的渗透率将稳步上升。

就市场细分而言,2024年,商用笔记本电脑由于全球裁员和经济政治不稳定,面临逆风,导致需求环境更为谨慎。然而,随着这些负面因素的消退和降息改善资本流动性,预计商用市场将在2025年恢复,年度出货增长超过7%。

另一方面,消费市场在2024年由于积极的促销活动而受到推动,入门级模型在销售中占主导地位,尤其是在北美。TrendForce预测,到2025年,消费市场将更为稳定,品牌将重新聚焦于高价值、高利润的模型。虽然消费者笔记本电脑的出货增长可能放缓至3%,但产品组合将看到显著的优化。

全球笔记本电脑市场仍与美国贸易政策紧密相连,特别是特朗普政府推出的“美国优先”政策下提高进口关税的潜在影响。这些措施可能影响美国的国内需求,取决于新政府实施这些政策的情况。

中国仍然是全球笔记本电脑生产的主要制造中心,占总产能的约89%。尽管一些ODM正在越南、泰国、印度和墨西哥扩大生产线,但在这些地区建立一个完全集成的供应链生态系统将需要时间。此外,相关政策的宣布和执行之间可能会有一个过渡期。(资料来源:集微网)

7) LG Innotek 投资19亿元升级产线,备战iPhone 17相机模块需求

LG Innotek 11月22日表示,将投资3759亿韩元(当前约19.38亿元人民币)用于相机模组工厂建设,以满足新机型的需求并提升竞争力。该投资将持续到明年



12 月，因此市场推测是为了生产明年的 iPhone 17 所用的相机模块。

韩国零部件制造商的消息人士称，苹果计划像往常一样在明年的手机中提高相机的规格，但只会在两款 Pro 机型中提供折叠变焦功能，就像 iPhone 16 一样。LG Innotek 是 iPhone 最大的相机模组供应商，已经拥有足够的生产能力。（资料来源：集微网）

2.4 汽车电子板块

1) 关税冲击，10 月中国电动汽车在欧洲交付份额进一步下滑至 8.2%

中国汽车制造商进军欧洲电动汽车市场继续遭遇阻力，在新关税出台前，10 月份其在欧洲的交付份额出现下滑。

研究公司 Dataforce 数据显示，包括上汽集团旗下 MG（名爵）和比亚迪在内的制造商占同期欧洲电动汽车注册量的 8.2%。这比 9 月份的 8.5% 有所下降，并且是市场份额连续第四个月低于去年同期水平。

在备受青睐的海外市场快速增长数年后，中国汽车制造商的扩张自 7 月份以来停滞不前。当时，欧盟对中国制造电动汽车征收临时关税，进口税高达 45%。经过数月与中国的谈判和对待定规则的调整，新增的最终关税于 10 月 30 日生效。

报道称，欧盟和中国之间的谈判仍在继续，但由于进展不大，目前仍难以达成以价格承诺取代关税的协议。（资料来源：集微网）

2.5 面板板块

1) 三星将推出 500Hz 27 英寸游戏显示器，采用 QD-OLED 面板

据报道，三星开发了世界上第一款分辨率为 1440p、刷新率为 500Hz 的 27 英寸 OLED 面板。这一突破旨在打造高性能游戏显示器，为 OLED 显示技术树立新的标杆，超过 LG UltraGear 27GX790A-B 和华硕 ROG Swift PG27AQDP 等型号的当前最高 480Hz 刷新率。

虽然三星的发布日期和详细规格尚未确定，但业内消息人士表示，该公司正在利用其尖端的 QD-OLED 技术。通过结合量子点和 OLED 技术，与传统 LCD 相比，QD-OLED 面板可提供出色的色彩鲜艳度、更深的对比度和更好的性能。这与 LG 显示和三星显示等显示器制造商的普遍趋势一致，它们竞相突破各种尺寸和分辨率的高刷新率 OLED 显示器的界限。

据报道，该面板正处于开发的最后阶段，目前正在与领先的显示器品牌合作讨论将其商业化。采用这款 500Hz 面板的游戏显示器预计将于明年上半年推出。然而，

创新竞赛并不局限于显示器的刷新率。（资料来源：集微网）

2) LGD 宣布组织架构重组，整合大尺寸和中尺寸制造中心

近日，LG Display (LGD) 宣布重组组织架构。该公司取消了首席生产主管 (CPO) 组织，并将大尺寸和中尺寸制造中心整合为大尺寸业务部门的一部分进行运营，以通过整合类似功能并简化组织结构来提高运营效率。

据业内消息，LGD 上周宣布取消了 CPO 组织，并将隶属于 CPO 的生产技术中心和采购团队等转至 CEO 直属。CPO 是负责管理公司国内外工厂运营的组织，此前已一直在缩减。

此外，LGD 大尺寸制造中心和中尺寸制造中心被整合为一个组织，作为大尺寸业务部门下的“中大尺寸制造中心”进行运营。下属组织也将整合为中大尺寸工厂、中大尺寸固定开发等部门。（资料来源：集微网）

3) 京东方 A：LCD 在未来 5-10 年仍将是 TV 产品主流技术

近日京东方 A 在接受机构调研时表示，公司认为各类显示技术将是共存的趋势，技术的进步将来源于场景的驱动。在大尺寸产品方面，目前来看，LCD 在未来 5-10 年仍将是 TV 产品的主流技术，同时，Mini LED 背光产品的成熟将进一步提升 LCD 产品的性能和生命力。大尺寸化、技术升级等将持续拉动 TV 市场增长。

中小尺寸方面，基于柔性 AMOLED 更好的显示效果、更轻薄的产品形态，以及在可折叠、卷曲等方面具备独特的优势，柔性 AMOLED 产品在中小尺寸领域，尤其是智能手机产品端渗透率持续提升，在高端 Pad、Notebook 等应用开始渗透。

近年来，随着行业内 LCD 生产线扩产逐步进入尾声，叠加部分海外厂商退出，行业整体集中度大幅提升，供给格局持续改善。在此背景下，行业内厂商持续坚持“按需生产”的经营策略。（资料来源：集微网）

3 公司动态跟踪

图表 9：过去一周股东增减持更新

证券代码	证券简称	公告日期	方向	股东名称	股东身份	拟变动数量上限	拟变动数量上限占总股本 (%)
300736.SZ	百邦科技	2024-11-26	减持	邓芳	持股 5%以上股东	3,795,249.00	2.92
300602.SZ	飞荣达	2024-11-26	减持	马飞	控股股东, 实际控制人	29,000,322.00	5.00
300285.SZ	国瓷材料	2024-11-27	减持	张曦	持股 5%以上股东, 实际控制人	49,860,000.00	5.00

						本次询价转让的出 让方电子院非芯动 联科的控股股东， 实际控制人，董事， 监事及高级管理人 员，持有芯动联科 股份比例超过 5%。	
688582.SH	芯动联科	2024-11-26	减持	北方电子研究院有限公司		4,007,000.00	1.00
603297.SH	永新光学	2024-11-27	减持	宁波新颖企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	5%以下股东	280,000.00	0.25
688127.SH	蓝特光学	2024-11-26	减持	章利炳	董事，监事，高级管 理人员	160,000.00	0.04
300936.SZ	中英科技	2024-11-29	减持	常州中英汇才股权投资管理中心 (有限合伙)	控股股东，实际控 制人的一致行动人	609,750.00	0.81
300739.SZ	明阳电路	2024-11-25	减持	张伟	财务总监	50,000.00	0.02
688322.SH	奥比中光 -UW	2024-11-29	减持	上海云鑫创业投资有限公司	5%以上非第一大股 东	12,000,000.00	3.00
301486.SZ	致尚科技	2024-11-27	减持	刘东生	持股 5%以上股东	3,822,409.00	3.00
688478.SH	晶升股份	2024-11-25	减持	卢祖飞	持股 5%以上股东	9,009,719.00	6.51
688361.SH	中科飞测	2024-11-27	减持	国投(上海)科技成果转化创业投 资基金企业(有限合伙)	5%以上非第一大股 东	6,400,000.00	2.00
688361.SH	中科飞测	2024-11-27	减持	深圳市创新投资集团有限公司	5%以上非第一大股 东	1,648,384.00	0.52
688361.SH	中科飞测	2024-11-27	减持	深圳市人才创新创业一号股权投 资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股 东	1,551,616.00	0.48
688260.SH	昀冢科技	2024-11-28	减持	苏州昀二企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他股东:控股股 东及实际控制人的 一致行动人	295,000.00	0.25
688260.SH	昀冢科技	2024-11-28	减持	苏州昀三企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他股东:控股股 东及实际控制人的 一致行动人	142,000.00	0.12
688260.SH	昀冢科技	2024-11-28	减持	苏州昀四企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他股东:控股股 东及实际控制人的 一致行动人	225,000.00	0.19
688260.SH	昀冢科技	2024-11-28	减持	苏州昀一企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	其他股东:控股股 东及实际控制人的 一致行动人	640,000.00	0.53
300812.SZ	易天股份	2024-11-25	减持	胡靖林	董事	1,804,000.00	1.29
300812.SZ	易天股份	2024-11-25	减持	高军鹏	总经理	2,952,000.00	2.11
300812.SZ	易天股份	2024-11-25	减持	柴明华	实际控制人	3,444,000.00	2.46
301348.SZ	蓝箭电子	2024-11-28	减持	上海银圣宇企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	持股 5%以上股东	2,000,000.00	1.00
002199.SZ	东晶电子	2024-11-27	减持	李庆跃	第一大股东	14,500,000.00	5.96

来源：Wind，华福证券研究所

图表 10：过去一周股权激励一览

代码	名称	公告日期	方案进度	激励方式	激励总数 (万)	激励总数占当 时总股本比例 (%)	期权初 始行权 价格
300301.SZ	*ST 长方	2024-11-28	董事会预案	上市公司定向发行股票	4,700.00	5.9485	1.00
688591.SH	泰凌微	2024-11-27	董事会预案	股票增值权	41.00	0.1708	13.92
688591.SH	泰凌微	2024-11-27	董事会预案	上市公司定向发行股票	439.00	1.8292	13.92
688595.SH	芯海科技	2024-11-28	董事会预案	上市公司定向发行股票	350.00	2.4574	37.00
002139.SZ	拓邦股份	2024-11-26	股东大会通过	上市公司定向发行股票及上市 公司提取激励基金买入流通股	3,300.00	2.6467	9.60

来源：Wind，华福证券研究所

4 风险提示

技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfyjs@hfbzq.com.cn